

HC-8045

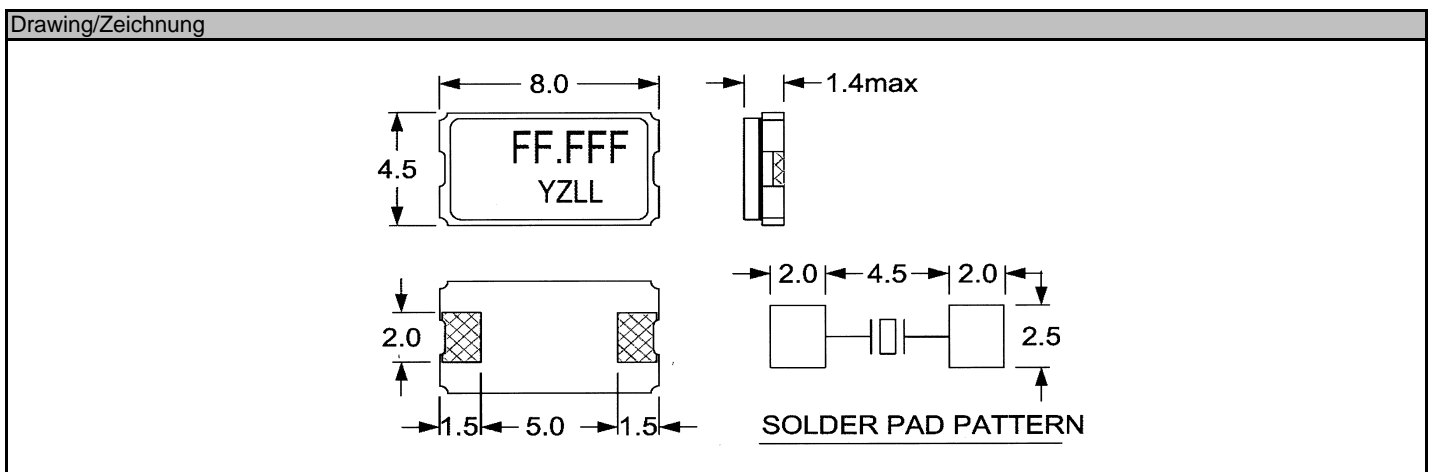
Features/Merkmale

- SMD Ceramic Enclosures/SMD Keramik Gehäuse
- High Reliability Seam Welded Seal/
sehr dichte Gehäuseverbindung
- Frequency Up to 80 MHz/bis zu 80MHz
- Ultra Thin Profile/sehr geringe Höhe



Specifications/Spezifikationen			
		Symbol	Remarks/Bemerkungen
Frequency range/Frequenz		f	8,000MHz - 30.000MHz
			30.000MHz - 80.000MHz
Frequency tolerance (std.), Ta=25°C / Frequenztoleranz		?f/f	± 30ppm, ± 50PPM
Load capacitance/Lastkapazität		C _L	Fund: 10pf - 8, O.T.: 5pF - 8
Temperature Tolerance (std.) / Temperaturtoleranz		?f/f	± 30ppm, ± 50ppm
Temperature range/ Temperaturbereich	Storage Temp./Lagertemp.	T _{STG}	-55°C - +125°C
	Operating Temp./Arbeitstemp.	T _{OPR}	-10°C - +70°C
Drive Level	Maximum drive level	M _{DL}	1000µW
	Recommended drive level	R _{DL}	20µW - 100µW
Series resistance/Serienwiderstand		R ₁	As Per Table/siehe Tabelle
Shunt capacitance/Statische Kapazität		C ₀	7pF max
Insulation resistance/Isolationswiderstand		IR	500M Ohm
Aging/Alterung		?f _A	± 5PPM/Year/Jahr max

Resistance of series Resonance (ESR), Serienwiderstand					
Frequency/Frequenz (MHz)	Mode/Schwingung	Ohm	Frequency/Frequenz (MHz)	Mode/Schwingung	Ohm
8 = f < 16	Fund	60	30 = f < 40	3 rd O.T	80
16 = f < 30	Fund	40	40 = f < 80	3 rd O.T	70
-	-	-	-	-	-



Dimensions/Abmessungen in mm

Remarks/Bemerkungen:

All specifications subject to change without notice. / Wir behalten uns vor Daten ohne Mitteilung zu ändern